

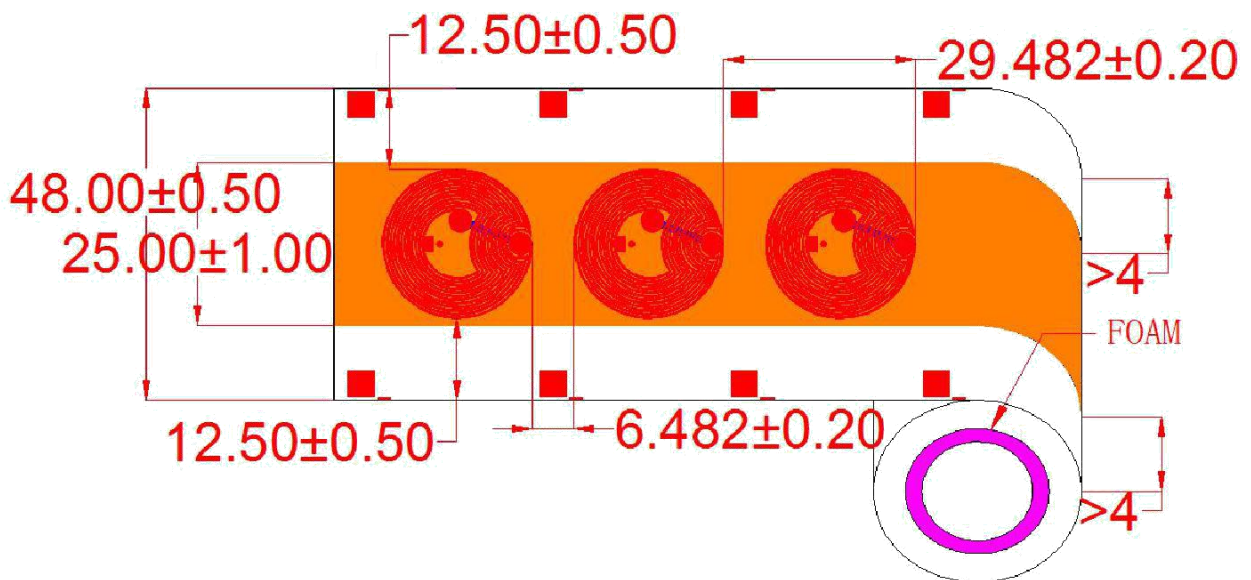
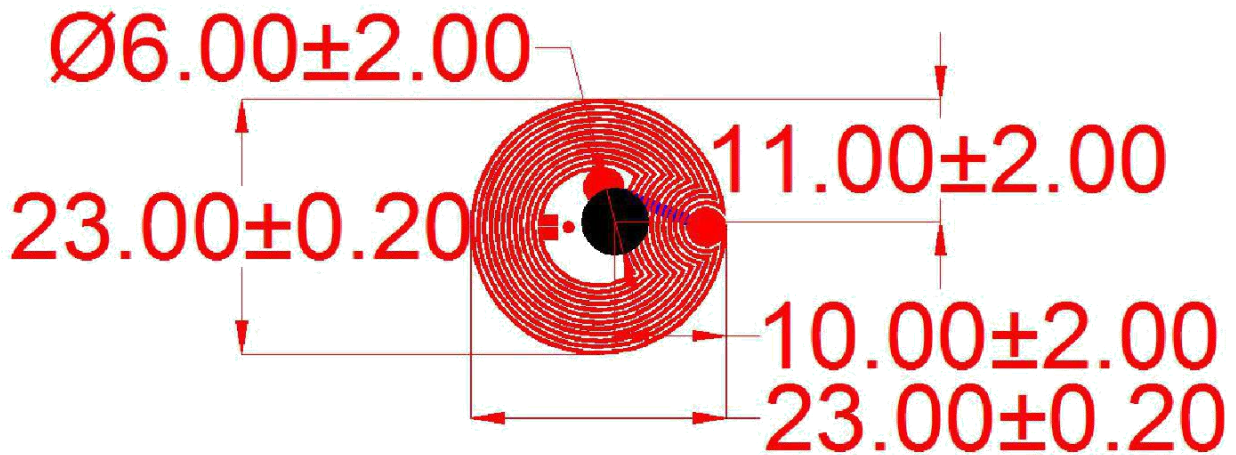
NO./Ver.	规格书/Specification	Page	1/3
RS-SPE-20190003/A		制/修订日期	2019.08.28

ø23mm_D213 Dry

KH-RFID-23-BQ

1 物理特性(Specification of Final Product)

1.1 外形(Appearance)



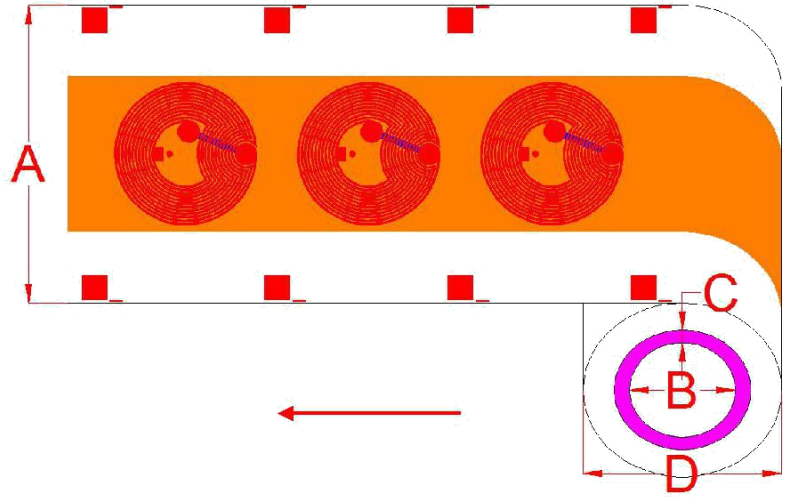
干 Inlay 正视图
Dry Inlay Front Side

深圳市金航标电子有限公司

NO./Ver.	规格书/Specification	Page	2/3
RS-SPE-20190003/A		制/修订日期	2019.08.28

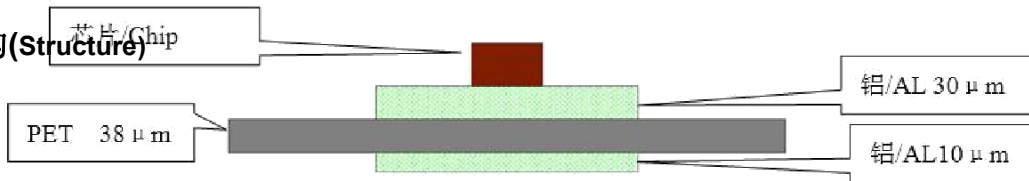
1.2 收卷规格(Reel Detail)

- A 筒芯幅宽 Web width: $48.00 \pm 0.5\text{mm}$
- B 筒芯内径 Inner core diameter:
 $3\text{inch}(76.20(+2.8/-0.4))$
- C 筒芯壁厚 Core thickness: $5 \pm 0.5\text{mm}$
- D 收卷外径 Roll size: $\leq 330\text{mm}$



成品出卷方向
Unwinding Direction

1.3 结构(Structure)



2 电气特性 (Electrical Characteristics)

项目 (Item)	描述 (Description)	备注 (Remarks)	
制造商/芯片 Manufacture /IC	金航标电子/D213		
基材材质 Base Material	PET		
天线制程方式 Antenna	铝蚀刻 +Al(10μm) Etched Aluminum (30μm) + PET (38μm) +Etched Aluminum (10μm)		
符合标准 Protocol	ISO 14443A		
芯片存储区 Memory	EPC	None	可读可写 Read & Write
	User Memory	1152 Bits	可读可写 Read & Write

深圳市金航标电子有限公司

NO./Ver.	规格书/Specification	Page	3/3
RS-SPE-20190003/A		制/修订日期	2019.08.28

	TID/Unique TID	56 Bits	可读不可写 Read Only
	密码区 Password	None	可读可写 Read & Write
适用载波频率 Frequency		13.56MHz	
工作模式 Operating Mode		无源 Passive	
芯片使用寿命 IC Life		写 10 万次, 数据保存 50 年 100,000 Programming cycles, 50years data retention	
芯片防静电(ESD)性能 ESD Voltage Immunity		最大 2000V Max. 2000V	人体模式 (HBM) Human body mode(HBM)

3 环境要求 (Environment Requirements)

操作温度/湿度 (Operating Temperature/Humidity): $-5\sim 60^{\circ}\text{C}$ / 20%~80% RH

储存温度/湿度 (Storage Temperature/Humidity): $20\sim 30^{\circ}\text{C}$ / 20%~60% RH

成品保质期 (Shelf Life): 在 $20\sim 30^{\circ}\text{C}$ / 20%~60% RH 条件下,使用防静电袋保存 1 年
(From the date of manufacture, 1 year in anti-static bag at $20\sim 30^{\circ}\text{C}$ / 20%~60% RH)

4 包装 (Packaging)

20000±50 pcs/ roll,3rolls /carton. Carton dimension is 350*350*160 mm.